

257

ESTUDO DA RECICLAGEM DE METAIS DE PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESSO (PCI).

Taiana R. Diehl, Hugo M. Veit, Andréa M. Bernardes (Laboratório de Corrosão, Proteção e Reciclagem de Materiais – Departamento de Materiais – Escola de Engenharia - UFRGS).

A geração cada vez maior de resíduos industriais exige atualmente uma atenção especial, na busca da reciclagem ou redução deste resíduo. Equipamentos utilizados na indústria de processamento de dados ou de entretenimento podem conter mais de 30% de PCI (Placas de Circuitos Impresso). A significativa concentração de metais em PCI estimula a tentativa de reciclagem deste material. Na primeira etapa deste trabalho as PCI passaram por uma separação prévia, sendo dividido em duas porções, a primeira as PCI não sofreram nenhum tratamento e na segunda porção os componentes eletrônicos que estavam soldados, foram retirados, gerando três tipos de amostras: PCI (completas), CE (somente os componentes eletrônicos) e SP (somente os substratos). Os três tipos de amostras passaram então por um processo de cominuição e separação granulométrica. Na etapa atual foram feitos ensaios para a separação dos metais utilizando três métodos diferentes: separação magnética, separação eletrostática e separação por densidade a fim de obter uma fração concentrada em metais (fração de interesse) e outra fração contendo polímeros e cerâmicos. (Fapergs, CNPq)